

江苏法德永衡律师事务所

为天水华天科技股份有限公司

首次公开发行人民币普通股(A股)并上市出具的

法律意见书

江苏法德永衡律师事务所

江苏省南京市珠江路 222 号长发科技大厦 13 楼

电话：86 25 83193322

传真：86 25 83191022

江苏法德永衡律师事务所
为天水华天科技股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市出具的
法律意见书

苏法永律股审字(2007)第 17 号

天水华天科技股份有限公司（发行人）：

根据贵公司与本所 2006 年 12 月签订的《专项法律顾问聘请合同》，本所依法接受贵公司委托，担任贵公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在证券交易所上市（以下简称“本次发行及上市”）的专项法律顾问。本所现根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称“《股票条例》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）等有关法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为贵公司本次发行及上市出具法律意见，并制作本法律意见书。

本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行及上市的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书和律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为发行人申请本次发行及上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书或律师工作报告的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

基于上述，本所律师根据《证券法》第十三条的要求，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次发行及上市的批准和授权

发行人于2007年3月10日召开了2006年度股东大会，就本次发行及上市审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》、《关于授权董事会在本次股东大会决议范围内办理首次发行人民币普通股（A股）事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）成功后发行前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》、《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）成功后适用的章程（草案）的议案》以及《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）相关决议有效期的议案》，批准发行人本次发行及上市。

经核查，本所律师认为：

(1) 发行人依法定程序召开了2006年度股东大会并作出批准本次发行及上市的决议。

(2) 发行人2006年度股东大会决议的内容，符合《公司法》和其他有关法律、行政法规以及发行人章程的规定，是合法有效的。

(3) 发行人2006年度股东大会授权发行人在本次股东大会通过的公开发行股票决议范围内全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的有关事宜的决议，符合《公司法》和其他有关法律、行政法规以及发行人章程的规定，是合法有效的。

二、发行人本次发行及上市的主体资格

(一) 发行人具有依照《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规规定发行上市的主体资格。

1、发行人系经甘肃省人民政府于2003年12月17日以甘政函[2003]146号《甘肃省人民政府关于同意设立天水华天科技股份有限公司的批复》批准，由天水华天微电子股份有限公司（发起时名称为“天水华天微电子有限公司”，以下简称“华天微电子”）、甘肃省电力投资集团公司（原名称为“甘肃省电力建设投资开发公司”，以下简称“甘电投”）、杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微电子”）、杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）、上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”）、无锡硅动力微电子股份有限公司（原名称为“无锡硅动力微电子有限公司”，以下简称“无锡硅动力”）、杨国忠、葛志刚（以下合称“发起人”）发起设立的股份有限公司。

2、根据北京五联方圆会计师事务所有限公司（原名称为“五联联合会计师事务所有限公司”，以下简称“五联方圆”）于2003年12月3日出具的五联验字(2003)第1014号《验资报告》，发行人发起设立时的注册资本9,500万元人民币已由发起人出资到位。

3、2003年12月25日，发行人领取了甘肃省工商行政管理局颁发的注册号为6200001052188的《企业法人营业执照》。

4、发行人现住所为甘肃省天水市秦州区双桥路14号，法定代表人为肖胜利，注册资本为人民币13,000万元，企业类型为股份有限公司，营业期限为50年。

经核查，本所律师认为，发行人具有依照《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规规定发行上市的主体资格。

（二）发行人依法有效存续

2006年5月，发行人的公司登记机关由甘肃省工商行政管理局变更为天水市工商行政管理局。发行人现持有天水市工商行政管理局颁发的注册号为6205001001841号的《企业法人营业执照》，并通过2005年度年检，发行人不存在根据法律、行政法规及发行人章程需要终止的情形。

经核查，本所律师认为，发行人是依法有效存续的股份有限公司。

三、本次发行及上市的实质条件

根据《公司法》、《证券法》、《首发办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，本所律师对发行人本次发行及上市依法应当满足的实质性条件逐项进行了审查：

1、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构，并设有生产、采购、销售等部门，各机构分工明确并依照规章制度行使各自的职能，相关机构和人员能够依法履行职责。因此，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第一项的规定。

2、根据五联方圆出具的五联方圆审字(2007)第071号《审计报告》（以下简称“《审计报告》”）以及五联方圆核字[2007]第034号《非经常性损益审核报告》

(以下简称“《非经常性损益审核报告》”),发行人在 2004 年度、2005 年度、2006 年度的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为人民币 21,020,715.12 元、人民币 28,102,398.58 元、人民币 61,770,311.20 元,累计为人民币 110,893,424.90 元。因此,发行人具有持续盈利能力,财务状况良好,符合《证券法》第十三条第一款第二项的规定。

3、根据《审计报告》,并经发行人书面确认,发行人最近三年财务会计文件不存在虚假记载,且不存在其他重大违法行为,符合《证券法》第十三条第一款第三项及其第五十条第一款第四项的规定。

4、发行人目前的股本总额为人民币 13,000 万元,股本总额超过人民币 3,000 万元,符合《证券法》第五十条第一款第二项的规定。

5、根据发行人 2006 年度股东大会决议,发行人本次拟向社会公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股,以发行 5,000 万股计算,占发行后股本总额 18,000 万股的 27.78%。发行人本次公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上,符合《证券法》第五十条第一款第三项的规定。

6、发行人系经甘肃省人民政府甘政函[2003]146 号《甘肃省人民政府关于同意设立天水华天科技股份有限公司的批复》批准,于 2003 年 12 月 25 日由发起人发起设立的股份有限公司,并已通过 2004 年、2005 年年检,是依法设立且合法存续的股份有限公司。

7、发行人自 2003 年 12 月 25 日成立股份有限公司后,持续经营时间已在三年以上。

8、根据五联方圆出具的五联验字(2003)第 1014 号《验资报告》、五联验字(2004)第 1011 号《验资报告》、五联方圆验字[2006]第 1006 号《验资报告》以及五联方圆验字[2006]第 1007 号《验资报告》验证,发行人的设立时和增资时的注册资本均已足额缴纳,发起人和其他股东用作出资的资产的产权转移手续已办理完毕;经核查,发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

9、经核查,发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策。

10、发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化,

实际控制人没有发生变更。

11、经核查，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

12、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

13、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人的资产完整。发行人具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

14、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人的人员独立。不存在发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪等情形，亦不存在发行人的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

15、根据《审计报告》，经发行人书面确认，并经本所核查，发行人的财务独立。发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；不存在发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户的情形。

16、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人的机构独立。发行人建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。

17、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人的业务独立。发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，其与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

18、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人在独立性方面不存在其他严重缺陷。

19、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职

责。

20、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

21、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在下列情形：

(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

(2)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，或最近十二个月内受到证券交易所公开谴责；

(3)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

22、根据五联方圆出具的五联方圆核字[2007]第 035 号《内部控制鉴证报告》（以下简称“《内控鉴证报告》”），经发行人书面确认，并经本所核查，发行人的内部控制制度健全，且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

23、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人不存在下列情形：

(1)最近三十六个月内未经法定机关依法核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在三十六个月前，但目前仍处于持续状态；

(2)最近三十六个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

(3)最近三十六个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

(4)本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(5)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

(6)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

24、发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，经发行人书面确认，并经本所核查，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

25、根据《审计报告》，经发行人书面确认，并经本所核查，发行人有严格的资金管理制度，不存在发行人资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

26、根据《审计报告》，并经本所核查，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常。

27、根据《内控鉴证报告》，经发行人书面确认，并经本所核查，发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并由五联方圆出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。

28、根据《审计报告》，并经发行人书面确认，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由五联方圆出具了无保留意见的《审计报告》。

29、根据《审计报告》，并经发行人书面确认，发行人编制财务报表以实际发生的交易或事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或相似的经济业务，选用了一致的会计政策，无随意变更的情形。

30、根据《审计报告》，经发行人书面确认，并经本所核查，发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，其关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。

31、发行人符合《首发办法》第三十三条规定的下列条件：

(1)根据《审计报告》和《非经常性损益审核报告》，发行人在 2004 年度、2005 年度、2006 年度的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为人民币 21,020,715.12 元、人民币 28,102,398.58 元、人民币 61,770,311.20

元，累计为人民币 110,893,424.90 元。因此，发行人最近 3 个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3,000 万元。

(2)根据《审计报告》，发行人最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计为人民币 234,044,379.89 元，超过了人民币 5,000 万元。

(3)发行人目前的股本总额为人民币 13,000 万元，股本总额超过人民币 3,000 万元。

(4)根据《审计报告》，发行人最近一期的无形资产（扣除土地使用权等后）为人民币 611,993.30 元，净资产为人民币 279,239,627.03 元，无形资产在净资产中所占比例为 0.22%，不高于 20%。

(5)根据《审计报告》，发行人最近一期末不存在未弥补亏损。

32、根据《审计报告》，经发行人书面确认，并经本所核查，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

33、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人不存在重大偿债风险，发行人不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

34、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人申报文件无下列情形：

(1)故意遗漏或虚构交易、事项或其他重要信息；

(2)滥用会计政策或会计估计；

(3)操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录及相关凭证。

35、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形：

(1)发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(2)发行人的行业地位或者发行人所处行业的经营环境已经或将发生重大变

化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3)发行人最近一个会计年度的营业收入或净利润对关联方或存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

(4)发行人最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(5)发行人在用的专利、专有技术等重要资产或技术的取得或使用存在重大不利变化的风险；

(6)其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

36、根据发行人于2007年3月10日召开的2006年度股东大会决议，发行人本次募集资金拟用于投资集成电路高端封装产业化项目。发行人本次募集资金有明确的使用方向，并全部用于其主营业务。

37、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人募集资金金额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

38、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规章的规定。

39、经发行人书面确认，并经本所核查，发行人董事会对募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

40、经发行人书面确认，并经本所核查，募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

41、经发行人书面确认，发行人将建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项帐户。

经核查，本所律师认为，发行人本次发行及上市符合我国《公司法》、《证券法》、《首发办法》等有关法律、行政法规、部门规章以及中国证监会规定的实质条件。

四、发行人的设立

(一) 发行人的设立

经核查,本所律师认为,发起人发起设立发行人的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的规定,并得到有权部门的批准。

(二) 发行人设立过程中签订的相关协议

经核查,本所律师认为,上述发行人发起设立过程中所签订的相关协议符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定,不会因此引致发行人发起设立行为存在潜在纠纷。

(三) 发行人的验资

2003年12月3日,五联方圆就发起人的出资情况出具了五联验字(2003)第1014号《验资报告》。根据前述《验资报告》,截止2003年12月3日,发行人注册资本9,500万元人民币已由发起人出资到位。

就华天微电子出资的净资产价值,甘肃弘信会计师事务所有限公司出具了甘弘会评报字(2003)第059号、甘弘会评报字(2003)第059-1号《天水华天微电子有限公司部分资产评估报告书》,甘肃方圆不动产咨询评估中心有限公司出具了甘方估字2003047号《土地估价报告》。

经核查,本所律师认为,发行人发起设立过程中有关的资产评估、验资履行了必要程序,符合当时法律、法规及规范性文件的规定。

(四) 发行人的创立大会

2003年12月21日,发行人创立大会在兰州阳光大厦召开,出席会议的发起人共八人,代表股份数为9,500万股,占发行人总股本的100%。会议讨论通过了《天水华天科技股份有限公司筹建报告》和《公司章程》,并审核通过了发行人的设立费用以及发起人的出资情况,选举产生了发行人第一届董事会成员和由股东代表出任的第一届监事会成员。

经核查,本所律师认为,发行人创立大会的程序及所议事项符合法律、法规及规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

(一) 经核查，本所律师认为，发行人业务独立于股东单位及其他关联方。

(二) 经核查，本所律师认为，发行人的资产独立完整。

(三) 经核查，本所律师认为，发行人拥有独立完整的供应、生产、销售系统。

(四) 经核查，本所律师认为，发行人的高级管理人员和财务人员已完全独立于其股东。发行人的董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生，不存在任何股东单位超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况，发行人的人员独立。

(五) 经核查，本所律师认为，发行人的机构独立。

(六) 经核查，本所律师认为，发行人的财务独立。

(七) 经核查，本所律师认为，发行人具有面向市场自主经营的能力。

六、发起人及现有股东

(一) 发行人的发起人及现有股东情况

发行人发起人为 8 人，分别为华天微电子、甘电投、士兰微电子、友旺电子、上海贝岭、无锡硅动力、杨国忠、葛志刚。经过历次股份转让和增资扩股，发行人现有股东为 10 人，分别为华天微电子、盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）、上海盛宇企业投资有限公司（以下简称“盛宇投资”）、士兰微电子、友旺电子、上海遐略投资咨询有限公司（以下简称“遐略投资”）、上海贝岭、无锡源生创业投资有限责任公司（以下简称“无锡源生”）、杨国忠、葛志刚。

经核查，本所律师认为，发行人的发起人以及现有股东均为自然人或在中华人民共和国依法注册成立并有效存续的法人单位，具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格。

(二) 发行人的实际控制人

1、实际控制人

1) 发行人的实际控制人为控股股东华天微电子的前十六大自然人股东肖胜利、刘建军、张玉明、宋勇、耿树坤、常文瑛、崔卫兵、杜忠鹏、杨前进、陈建军、薛延童、周永寿、乔少华、张兴安、边席科和韩承真（以下简称“16名自然人”）。

2) 根据16名自然人于2003年8月20日签订的《一致行动协议书》，16名自然人自身在签署该等协议当时对华天微电子的出资共计1,006万元人民币，占华天微电子当时注册资本的37.54%，其共同承诺在华天微电子股东会就任何事项进行表决时保持投票的一致性。

3) 根据16名自然人于2006年12月26日签订的《关于天水华天微电子股份有限公司之一致行动协议》，其共同承诺在华天微电子股东大会就一致行动事项进行表决时保持投票一致性，并就一致行动人行使表决权的程序和方式等进行了详细约定。

4) 根据《天水华天微电子股份有限公司章程》和华天微电子工商登记资料，16名自然人现合计持有华天微电子70.08%的股权。

经核查，本所律师认为，16名自然人共同控制发行人控股股东华天微电子，为发行人的实际控制人；16名自然人均具有完全民事行为能力。

(三) 发起人的人数、住所及出资比例

经核查，本所律师认为，发行人的发起人共八名，其住所均在中华人民共和国境内，发起人及现有股东人数、住所、出资比例符合法律、法规及规范性文件关于设立股份有限公司的规定。

(四) 发起人投入发行人资产的产权

经核查，本所律师认为，发起人已投入发行人的资产的产权关系清晰，将前述资产投入发行人不存在法律障碍。

(五) 发起人投入发行人的资产或权利的权属证书的转移

经核查，本所律师认为，发起人投入发行人的资产或权利的权属证书已由发

起人转移给发行人，不存在法律障碍或风险。

七、发行人的股本及其演变

(一) 发行人设立时的股权设置和股本结构

1、根据发行人工商登记资料，发行人设立时的股本结构和股权性质如下：

股份类别/股东名称	股份数(万股)	持股比例(%)	股权性质
法人股			
天水华天微电子股份有限公司	4,500	47.37	社会法人股
甘肃省电力投资集团公司	3,500	36.84	国有法人股
杭州士兰微电子股份有限公司	500	5.26	社会法人股
杭州友旺电子有限公司	500	5.26	社会法人股
上海贝岭股份有限公司	100	1.05	社会法人股
无锡硅动力微电子股份有限公司	50	0.53	社会法人股
自然人股			
杨国忠	200	2.11	自然人股
葛志刚	150	1.58	自然人股
合 计	9,500	100	

2、经本所律师核查，发行人设立时未取得国有资产管理部门出具的关于国有股权管理的批复文件；但在发行人 2004 年增资扩股的审批过程中，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃国资委”）以甘国资函[2004]22 号《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于同意天水华天科技股份有限公司增资扩股的函》，对发行人的股权设置和股权性质予以界定和确认。

经核查，本所律师认为，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

(二) 发行人历次股权变动

1、发行人 2004 年增资扩股

1) 2004 年 3 月 9 日，发行人股东华天微电子、甘电投、士兰微电子、友旺电子、上海贝岭、无锡硅动力、杨国忠、葛志刚与盈富泰克签订了《天水华天科技股份有限公司增资协议》，约定发行人注册资本增加 1,500 万元，即由 9,500 万元人民币增加至 11,000 万元人民币；本次增资全部由盈富泰克以现金 1,500

万元人民币认购（以下简称“2004年增资扩股”）。

2) 发行人2004年增资扩股经发行人2004年第二次股东大会以及经甘肃省人民政府批准。截至2004年7月8日，发行人2004年增资扩股的工商变更登记手续办理完毕。

经核查，本所律师认为：

(1) 发行人2004年增资扩股履行了必要的法律手续，并依法办理了工商变更登记；

(2) 发行人2004年增资扩股与发行人设立时发行股份时间间隔不足一年，未满足当时《公司法》规定的公司发行新股的条件；但因自2006年1月1日实施的最新修订的《公司法》、《证券法》取消了两次股票发行需间隔一年以上等非上市股份有限公司非公开发行新股条件的规定，而发行人2004年增资扩股也已履行了当时法律法规所需的政府批准等必要法律手续，因此该等情形不构成本次发行及上市的实质性法律障碍。

2、发行人2006年第一次股权转让及增资扩股

1) 甘电投转让其持有的发行人股权

a) 经甘肃国资委批准，甘电投在甘肃省产权交易所进场交易后，于2006年7月11日与华天微电子、盛宇投资签订了《股权转让协议》，甘电投将其持有发行人的3,500万股股份分别以2,254.5万元人民币的转让价款向华天微电子转让1,350万股股份；以3,950.5万元人民币的转让价款向盛宇投资转让2,150万股股份（以下简称“2006年第一次股权转让”）。

b) 2006年7月12日，甘肃省产权交易所有限责任公司以甘产交鉴[2006]19-1号、甘产交鉴[2006]19-2号《交易鉴证书》，确认2006年第一次股权转让行为符合法定程序，交易结果合法有效。发行人根据2006年第一次股权转让修改后的章程已办理完毕工商备案手续。

2) 发行人2006年增资扩股

a) 根据发行人2006年第一次股东大会决议，发行人决定增资扩股2,000万股，公司总股本变更为13,000万股；其中：华天微电子以现金出资1,085.5万元人民币认购650万股股份，士兰微电子以现金出资835万元人民币认购500万股

股份,友旺电子以现金出资 835 万元人民币认购 500 万股股份,杨国忠以现金出资 501 万元人民币认购 300 万股股份,无锡硅动力以现金出资 83.5 万元人民币认购 50 万股股份。

b) 截至 2006 年 7 月 21 日,发行人领取了天水市工商行政管理局颁发的注册号为 6205001001841 的《企业法人营业执照》,注册资本变更为人民币 13,000 万元,发行人 2006 年增资扩股的工商变更登记手续办理完毕。

经核查,本所律师认为,发行人 2006 年第一次股权转让及增资扩股合法、合规、真实、有效。

3、发行人 2006 年第二次股权转让

1) 根据盛宇投资与遐略投资于 2006 年 9 月 28 日签订的《股权转让协议》,盛宇投资将其持有发行人的 2,150 万股股份中的 660 万股股份以 1,102.2 万元人民币的转让价款转让给遐略投资。

2) 根据无锡硅动力与无锡源生于 2006 年 11 月 18 日签订的《股权转让协议》,无锡硅动力将其持有发行人的 100 万股股份以 133.45 万元人民币的转让价款全部转让给无锡源生(与前项股权转让合称“2006 年第二次股权转让”)。

3) 根据发行人 2006 年 11 月 29 日召开的 2006 年第三次股东大会决议和发行人工商登记资料,发行人已根据 2006 年第二次股权转让修改公司章程,并就章程修改办理完毕工商备案手续。

经核查,本所律师认为,发行人 2006 年第二次股权转让合法、合规、真实、有效。

4、发行人现行股本结构为:

股份类别/股东名称	股份数(万股)	持股比例(%)
法人股		
天水华天微电子股份有限公司	6,500	50.00
盈富泰克创业投资有限公司	1,490	11.54
上海盛宇企业投资有限公司	1,500	11.46
杭州士兰微电子股份有限公司	1,000	7.69
杭州友旺电子有限公司	1,000	7.69
上海遐略投资咨询有限公司	660	5.08
上海贝岭股份有限公司	100	0.77
无锡源生创业投资有限公司	100	0.77
自然人股		
杨国忠	500	3.85
葛志刚	150	1.15
合 计	1,3000	100

(三) 发行人股东所持发行人股份质押的情况

经核查，本所律师认为，发行人所持发行人的股份不存在质押情况。

八、发行人的业务

(一) 经核查，本所律师认为，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 经核查，本所律师认为，发行人未在中国大陆以外经营。

(三) 经核查，本所律师认为，自发行人设立至今，发行人主营业务未发生变更。

(四) 经核查，本所律师认为，发行人主营业务突出。

(五) 经核查，本所律师认为，发行人不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

(一) 发行人的关联方

1、发行人最近三年存在的关联方及关联关系如下：

关联方	关联关系
天水华天微电子股份有限公司	控股股东，现持有发行人 50% 股权
天水华天传感器有限公司	控股股东控股子公司
深圳市天麦特电子有限公司	其法定代表人曾与发行人法定代表人同为肖胜利
天水永红器材厂	发行人法定代表人与其法定代表人同为肖胜利
天水七四九电子有限公司	发行人法定代表人与其法定代表人同为肖胜利
天水华天集成电路包装材料有限公司	华天微电子曾持有其 100% 股权，2007 年 3 月发行人收购该 100% 股权
天水华天机械有限公司	华天微电子原持有其 60% 股权，2007 年 3 月发行人收购该 60% 股权
甘肃省电力投资集团公司	发起人股东，2006 年 7 月将所持发行人全部股权转让给华天微电子和盛宇投资
杭州士兰微电子股份有限公司	发起人股东，现持有发行人 7.69% 股权
杭州友旺电子有限公司	发起人股东，现持有发行人 7.69% 股权
盈富泰克创业投资有限公司	非发起人股东，现持有发行人 11.54% 股权
上海盛宇企业投资有限公司	非发起人股东，现持有发行人 11.46% 股权
上海遐略投资咨询有限公司	非发起人股东，现持有发行人 5.08% 股权
无锡海威半导体科技有限公司	其法定代表人葛志刚曾任发行人监事
深圳环宇微电子电子有限公司	其法定代表人杨国忠曾任发行人监事
兰州永红电子科技有限公司	发行人总会计师宋勇曾任其法定代表人
厦门永红电子有限公司	发行人法定代表人肖胜利任其董事、 发行人董事张玉明任其监事

此外，发行人的董事、监事和高级管理人员等自然人也为发行人的关联方。该等董事、监事和高级管理人员详见本律师工作报告第十五部分“董事、监事和高级管理人员及其变化”。

(二) 发行人最近三年的主要关联交易

1、发行人 2004 年度发生的主要关联交易

1) 原材料采购

a) 2004年1月6日,发行人与华天微电子签订《存货购销协议》,约定发行人向华天微电子购买原材料,并根据甘肃弘信会计师事务所有限公司出具的甘弘会评报字(2004)第006号《天水华天电子有限公司部分资产评估报告书》确定购买价款为6,841,711.59元人民币。该等关联交易经发行人2004年第一次临时股东大会审议批准。

b) 2004年1月15日,发行人与华天包装签订《料管销售合同》,约定发行人向华天包装采购全年包装材料。根据《审计报告》,发行人在2004年度共计与华天包装发生采购包装材料的关联交易355.16万元人民币。该等关联交易经发行人2004年第一次临时股东大会审议批准。

c) 2004年1月至12月,发行人每月与厦门永红电子有限公司(以下简称“厦门永红”)签订当月《购销合同》约定,厦门永红向发行人提供相应的引线框架并通过汽车运输至发行人所在城市,货款支付方式为月结60天。根据《审计报告》,发行人在2004年度共计与厦门永红发生采购引线框架关联交易1,233.77万元人民币。该等关联交易经发行人2004年第一次临时股东大会审议批准。

2) 封装测试业务

a) 2004年1月10日,发行人与华天微电子签订《IC封装加工承揽协议》约定,发行人为华天微电子提供全年封装业务。根据《审计报告》,发行人在2004年度共计与华天微电子发生封装业务关联交易323.53万元人民币。该等关联交易经发行人2004年第一次临时股东大会审议批准。

b) 2004年1月11日,发行人与士兰微电子签订《委托加工协议书》约定,发行人在2004年为士兰微电子就其提供的半导体管芯进行封装加工、封装成品测试;士兰微电子每月29日前将下月加工总量的计划传真给发行人,具体产品价格按照市场行情由双方商定,结算方式为月结60天,支付方式为每次结算后的60日内支付相应结算款项。根据《审计报告》,发行人在2004年度共计与士兰微电子发生封装业务关联交易2,723.37万元人民币。该等关联交易经发行人2004年第一次临时股东大会审议批准。

c) 2004年12月29日,发行人与友旺电子签订《委托加工协议书》约定,发行人为友旺电子提供全年DIP、SOP等系列封装业务。根据《审计报告》,发行人在2004年度共计与友旺电子发生封装业务关联交易561.68万元人民币。该等关联交易经发行人2004年第一次临时股东大会审议批准。

d) 2004 年 1 月 14 日,发行人与无锡海威签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》约定,发行人在 2004 年为无锡海威就其提供的集成电路芯片进行塑封加工服务,无锡海威提前一个月书面通知发行人下月的封装数量,货款每月结算一次。根据《审计报告》,发行人在 2004 年度共计与无锡海威发生封装业务关联交易 4,836.58 万元人民币。该等关联交易经发行人 2004 年第一次临时股东大会审议批准。

e) 2004 年 1 月 8 日,发行人与深圳环宇签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》约定,发行人在 2004 年为深圳环宇就其提供的集成电路芯片进行塑封加工服务;深圳环宇提前一个月书面通知发行人下月的封装数量,以每月的最后一天作为结算终止期,每月结算一次,以电汇支付相应结算款项。根据《审计报告》,发行人在 2004 年度共计与深圳环宇发生封装业务关联交易 952.27 万元人民币。该等关联交易经发行人 2004 年第一次临时股东大会审议批准。

3) 借款

2004 年 12 月 27 日,发行人与华天微电子签署《借款协议书》约定,发行人向华天微电子借款 1,300 万元人民币,年利率 5.58%,期限为 2004 年 12 月 27 日至 2006 年 12 月 26 日。根据《审计报告》,上述借款已归还,发行人支付资金使用费 145.08 万元人民币。该等关联交易经发行人 2004 年第三次临时股东大会批准。

4) 其他

根据《审计报告》,由于发行人于 2003 年末设立,为保持生产经营的连续,发行人在 2004 年度向华天微电子购买材料 920,119.73 元人民币,同时向华天微电子支付了代垫设备及材料款 14,805,882.55 元人民币。该等关联交易经发行人 2004 年第一次临时股东大会审议批准。

2、发行人 2005 年度发生的主要关联交易

1) 原材料采购

a) 2005 年 2 月 9 日,发行人与华天包装签订《料管销售合同》约定,华天包装向发行人提供全年包装材料。根据《审计报告》,发行人在 2005 年度共计与

华天包装发生采购包装材料的关联交易 640.35 万元人民币。该等关联交易经发行人 2004 年度股东大会审议批准。

b) 2005 年 1 月至 12 月, 发行人每月与厦门永红签订当月《购销合同》约定, 厦门永红向发行人提供相应的引线框架并通过汽车运输至发行人所在城市, 货款支付方式为月结 60 天。根据《审计报告》, 发行人在 2005 年度共计与厦门永红发生采购引线框架关联交易 1,543.80 万元人民币。该等关联交易经发行人 2004 年度股东大会审议批准。

2) 封装测试业务

a) 2005 年 1 月 6 日, 发行人与深圳环宇签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》约定, 发行人在 2005 年为深圳环宇就其提供的集成电路芯片进行塑封加工服务; 深圳环宇提前一个月书面通知发行人下月的封装数量, 以每月的最后一天作为结算终止期, 每月结算一次, 以电汇支付相应结算款项。根据《审计报告》, 发行人在 2005 年度共计与深圳环宇发生封装业务关联交易 1,466.47 万元人民币。该等关联交易经发行人 2004 年度股东大会审议批准。

b) 2004 年 12 月 27 日, 发行人与士兰微电子签订《委托加工协议书》约定, 在 2005 年为士兰微电子就其提供的半导体管芯进行封装加工、封装成品测试; 士兰微电子每月 29 日前将下月加工总量的计划传真给发行人, 具体产品价格按照市场行情由双方商定, 结算方式为月结 60 天, 支付方式为每次结算后的 60 日内支付相应结算款项。根据《审计报告》, 发行人在 2005 年度共计与士兰微电子发生封装业务关联交易 4,193.54 万元人民币。该等关联交易经发行人 2004 年度股东大会审议批准。

c) 2004 年 12 月 28 日, 发行人与友旺电子签订《委托加工协议书》约定, 发行人在 2005 年为友旺电子就其提供的半导体管芯进行封装加工、封装品测试。友旺电子每月 29 日前将下月加工总量的计划传真给发行人, 具体产品价格按照市场行情由双方商定, 结算方式为月结 60 天, 支付方式为每次结算后的 60 日内支付相应结算款项。根据《审计报告》, 发行人在 2005 年度共计与友旺电子发生封装业务关联交易 1,104.61 万元人民币。该等关联交易经发行人 2004 年度股东大会审议批准。

d) 2005 年 1 月 10 日, 发行人与无锡海威签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》约定, 发行人为无锡海威就其提供的集成电路芯

片进行塑封加工服务；无锡海威提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次，以电汇支付相应结算款项。根据《审计报告》，发行人在 2005 年度共计与无锡海威发生封装业务关联交易 4,207.53 万元人民币。该等关联交易经发行人 2004 年度股东大会审议批准。

3) 借款

a) 2005 年 3 月 14 日，发行人与天水华天微电子股份有限公司工会（原名称“天水华天微电子有限公司工会”，以下简称“华天微电子工会”）签署《借款协议书》约定华天微电子工会将职工集资款借给发行人使用，年利率 5.58%，并根据国家利率调整一年一定。根据《审计报告》，截止 2006 年 11 月 30 日，该等借款累计余额为 2,396 万元人民币，并于该日全部归还华天微电子工会。该等关联交易经 2004 年度股东大会批准。

b) 2005 年 11 月 1 日，发行人与盈富泰克签署《资金使用协议书》，发行人向盈富泰克借款 1,000 万元人民币，年利率 5.58%，期限为 2005 年 11 月 1 日至 2007 年 11 月 1 日。发行人已于 2006 年 10 月 23 日提前归还该项借款，并向盈富泰克支付资金使用费 55.8 万元人民币。该项关联交易经发行人第一届第八次董事会会议批准。

c) 2005 年 11 月 2 日，发行人与无锡海威签署《资金使用协议书》，发行人向无锡海威借款 500 万元，年利率 5.58%，期限为 2005 年 11 月 9 日至 2007 年 11 月 8 日。该项关联交易经发行人第一届第八次董事会会议批准。2006 年 11 月 8 日，发行人于与无锡海威签署《抵账协议》，以该笔资金抵消发行人应收无锡海威货款 500 万元人民币，并支付资金使用费 27.9 万元人民币。该项关联交易经发行人第十一届第十一次董事会会议批准。

3、发行人 2006 年度发生的主要关联交易

1) 原材料采购

a) 2006 年 1 月 12 日，发行人与华天包装签订《料管销售合同》约定，华天包装向发行人提供全年防静电塑料包装管及封塞、销钉，数量以发行人的实际需要数量为准，付款方式为两个月结款。根据《审计报告》，发行人在 2006 年度共计与华天包装发生采购包装材料的关联交易 920.38 万元人民币。该等关联交易经发行人 2005 年度股东大会审议批准。

b) 2006 年 1 月至 12 月, 发行人每月与厦门永红签订当月《购销合同》约定, 厦门永红向发行人提供相应的引线框架并通过汽车运输至发行人所在城市, 货款支付方式为月结 60 天。根据《审计报告》, 发行人在 2005 年度共计与厦门永红发生采购引线框架关联交易 2,293.22 万元人民币。该等关联交易经发行人 2005 年度股东大会审议批准。

2) 封装测试业务

a) 2005 年 12 月 29 日, 发行人与深圳环宇签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》约定, 发行人在 2006 年为深圳环宇就其提供的集成电路芯片进行塑封加工服务, 深圳环宇提前一个月书面通知发行人下月的封装数量, 以每月的最后一天作为结算终止期, 每月结算一次, 以电汇支付相应结算款项。根据《审计报告》, 发行人在 2006 年度共计与深圳环宇发生封装业务关联交易 1,993.94 万元人民币。该等关联交易经发行人 2005 年度股东大会审议批准。

b) 2005 年 12 月 23 日, 发行人与士兰微电子签订《委托加工协议书》约定, 在 2006 年为士兰微电子就其提供的半导体管芯进行封装加工、封装成品测试; 士兰微电子每月 29 日前将下月加工总量的计划传真给发行人, 具体产品价格按照市场行情由双方商定, 结算方式为月结 60 天, 支付方式为每次结算后的 60 日内支付相应结算款项。根据《审计报告》, 发行人在 2006 年度共计与士兰微电子发生封装业务关联交易 4,734.17 万元人民币。该等关联交易经发行人 2005 年度股东大会审议批准。

c) 2006 年 1 月 6 日, 发行人与友旺电子签订《委托加工协议书》约定, 发行人在 2006 年为友旺电子就其提供的半导体管芯进行封装加工、封成品测试; 友旺电子每月 29 日前将下月加工总量的计划传真给发行人, 具体产品价格按照市场行情由双方商定, 结算方式为月结 60 天, 支付方式为每次结算后的 60 日内支付相应结算款项。根据《审计报告》, 发行人在 2006 年度共计与友旺电子发生封装业务关联交易 1,620.29 万元人民币。该等关联交易经发行人 2005 年度股东大会审议批准。

d) 2005 年 12 月 28 日, 发行人与无锡海威签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》约定, 发行人为无锡海威就其提供的集成电路芯片进行塑封加工服务; 无锡海威提前一个月书面通知发行人下月的封装数量; 以每月的最后一天作为结算终止期, 每月结算一次, 以电汇支付相应结算款项。根据《审计报告》, 发行人在 2006 年度共计与无锡海威发生封装业务关联交易

6,971.72 万元人民币。该等关联交易经发行人 2005 年度股东大会审议批准。

3) 借款

a) 2006 年 2 月 16 日，发行人与华天微电子签署《借款协议书》，发行人向华天微电子借款 500 万元人民币，年利率 5.58%，借款期限为 2006 年 2 月 17 日至 2006 年 5 月 16 日。该项借款经发行人第一届董事会第八次会议批准。

b) 2006 年 12 月 5 日，发行人与中国农业银行天水市分行（以下简称“天水农行”）签署第 62130200600002864 号《委托贷款借款合同》约定，天水农行接受华天微电子工会委托贷款 1,700 万元人民币给发行人使用，年利率 6.30%，借款期限为 2006 年 12 月 7 日至 2009 年 12 月 9 日。该项借款经发行人第一届董事会第十二次会议批准。

4、发行人 2007 年度发生的关联交易

1) 原材料采购

a) 2007 年 1 月 20 日，发行人与厦门永红签订《长期供货协议》约定，厦门永红在 2007 年向发行人提供引线框架，引线框架的具体型号、规格、数量质量标准以发行人的通知或按双方的约定标准，具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定，若无国家物价管理部门规定的价格，则依据当地的市场价格双方议定，若没有当地的市场价格可依据，以同类产品的市场价格双方议定。该项关联交易经发行人 2007 年第一次临时股东大会批准。

b) 2007 年 1 月 2 日，发行人与华天包装签订《料管销售合同》约定，华天包装在 2007 年向发行人提供防静电塑料包装管及封塞、销钉，数量以发行人的实际需要数量为准，付款方式为两个月结款。该项关联交易经发行人 2007 年第一次临时股东大会批准。

2) 封装测试业务

a) 2006 年 12 月 31 日，发行人与士兰微电子签订《委托加工协议书》约定，在 2007 年为士兰微电子就其提供的半导体管芯进行封装加工、封成品测试；士兰微电子每月 29 日前将下月加工总量的计划传真给发行人，具体产品价格按照市场行情由双方商定，结算方式为月结 60 天，支付方式为每次结算后的 60 日内支付相应结算款项。该项关联交易经发行人 2007 年第一次临时股东大会批准。

b) 2006年12月26日,发行人与友旺电子签订《委托加工协议书》约定,发行人在2007年为友旺电子就其提供的半导体管芯进行封装加工、封成品测试;友旺电子每月29日前将下月加工总量的计划传真给发行人,具体产品价格按照市场行情由双方商定,结算方式为月结60天,支付方式为每次结算后的60日内支付相应结算款项。该项关联交易经发行人2007年第一次临时股东大会批准。

c) 2007年1月14日,发行人与无锡海威签订《IC封装加工承揽协议》及《IC封装加工承揽协议附件》约定,发行人在2007年为无锡海威就其提供的集成电路芯片进行塑封加工服务;无锡海威提前一个月书面通知发行人下月的封装数量;以每月的最后一天作为结算终止期,每月结算一次,以电汇支付相应结算款项。该项关联交易经发行人2007年第一次临时股东大会批准。

d) 2007年1月11日,发行人与深圳环宇签订《IC封装加工承揽协议》及《IC封装加工承揽协议附件》约定,发行人在2007年为深圳环宇就其提供的集成电路芯片进行塑封加工服务;深圳环宇提前一个月书面通知发行人下月的封装数量,以每月的最后一天作为结算终止期,每月结算一次,以电汇支付相应结算款项。该项关联交易经发行人2007年第一次临时股东大会批准。

3) 收购资产

a) 为减少关联交易,发行人与华天微电子于2007年3月12日签订《股权转让协议书》约定,发行人收购华天微电子持有华天包装100%的股权,并根据五联方圆出具的五联方圆审字[2007]第074号《审计报告》认定的华天包装截止2007年2月28日的净资产值,确定转让价款为16,992,361.70元人民币。该项关联交易经发行人第二届董事会第二次会议批准。根据天水市工商行政管理局企业登记注册中心2007年3月16日出具的《内资(公司)企业变更通知书》,本次股权转让已办理完毕工商变更登记手续。

b) 为减少关联交易,发行人与华天微电子于2007年3月12日签订《股权转让协议书》约定,发行人收购华天微电子持有华天机械60%的股权,并根据五联方圆出具的五联方圆审字[2007]第073号《审计报告》认定的华天机械截止2006年12月31日的净资产值,确定转让价款为2,804,195.48元人民币。该项关联交易经发行人第二届董事会第二次会议批准。本次股权转让的工商变更登记手续正在办理过程中。

c) 为减少关联交易,发行人与华天微电子于2007年3月15日签订《土地

使用权转让协议》约定，发行人受让华天微电子位于天水市双桥路 14 号的土地使用权共计 2,408 平方米，并根据甘肃方家不动产评估咨询有限公司出具的甘房估字 2007002 号《房地产评估报告》，确定转让价款为 144.49 万元人民币。该项关联交易经发行人第二届董事会第二次会议批准。本次土地使用权转让的过户手续正在办理过程中。

经核查，本所律师认为，上述关联交易中发行人与关联法人之间的借款行为虽未采取银行委托贷款的规范方式进行，但上述关联交易均是公允的，不存在损害发行人及其他股东利益的情况；在上述关联交易中，发行人已经采取了必要措施以保护发行人小股东的利益，如按照市场方法确定交易价格、关联董事或关联股东回避表决、按照关联交易决策程序进行决策等。

(三) 规范关联交易的制度安排

为保证关联交易的公允性，保护中小股东利益，发行人现行章程、首次公开发行成功后的章程(草案)(以下简称“《章程(草案)》”)、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等文件对关联交易的决策权力和程序作了明确规定。

经核查，本所律师认为：

(1) 发行人现行章程、《章程(草案)》以及其他内部规定中明确了发行人在审议关联交易时，关联股东和关联董事实行回避，确立了关联交易公允决策的程序；

(2) 发行人已对有关解决关联交易的承诺或措施进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

(四) 发行人的同业竞争

1、发行人的同业竞争状况

经核查，发行人与华天微电子、天水华天传感器有限公司、天水七四九电子有限公司、16 名自然人之间不存在相同业务，不存在同业竞争。

2、发行人关于避免同业竞争的安排

1) 为了维护发行人的合法权益，发行人和华天微电子就双方间的可能出现的同业竞争事宜于 2007 年 3 月签订了《避免竞争和优先选择协议》。

2) 华天微电子、盛宇投资、盈富泰克、士兰微电子、友旺电子、遐略投资以及16名自然人已于2007年3月签署了《关于避免同业竞争的非竞争承诺书》。

经核查，本所律师认为：

(1)上述《避免竞争和优先选择协议》和《关于避免同业竞争的非竞争承诺书》是合法有效的，对华天微电子、盛宇投资、盈富泰克、士兰微电子、友旺电子、遐略投资以及16名自然人具有法律约束力；

(2) 发行人已对有关解决同业竞争的承诺或措施进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

(一) 房屋建筑物和土地使用权

截止2006年12月31日，发行人房屋建筑物账面净值为28,683,903.63元人民币，其拥有的房屋建筑物和土地使用权详细情况如下：

1、房屋

序号	产权证编号	坐落	建筑面积 (M ²)	用途
1	天房权证秦字第53696号	天水市秦城区双桥路14号 C-15-85	6,629.26	工业厂房
2	天房权证秦字第61314号	天水市秦城区双桥路14号	11,176.24	工业厂房

2、土地使用权

序号	土地使用权编号	坐落	类型	面积 (M ²)	用途	终止日期
1	天国用(2004)秦字第028号	天水市秦州区双桥路14号	出让	29183	工业	2053年1月

3、权利限制

根据发行人与天水农行签订的 No.62906200600000520《最高额抵押合同》，发行人将上述房屋和土地使用权抵押给天水农行，为发行人自2006年8月30日至2008年8月30日在水天农行办理各类业务所实际形成的债务最高余额4,000万元人民币提供担保。根据上述房屋和土地使用权的权属证书，上述抵押登记手

续已办理完毕，房屋抵押期限为 2006 年 8 月 28 日至 2008 年 8 月 27 日，土地使用权抵押期限为 2006 年 8 月 30 日至 2008 年 8 月 30 日。

经核查，本所律师认为，发行人目前使用的土地使用权及房屋均已办理完毕所需的权证手续，并已取得完备的权属证书。发行人上述房屋及建筑物是在发行人设立时由天水华天微电子股份有限公司出资而取得或设立后自建取得的，所有权不存在争议。

(二) 专利权

1、发行人拥有下列专利权：

序号	专利名称	专利类型	专利证书号	专利号	有效期限
1	光电一体化红外接收器	外观设计	第 526797 号	ZL 2005 3 0089960.1	2005 年 6 月 21 日至 2015 年 6 月 20 日止
2	点接触式硅片测厚仪	实用新型	第 854581 号	ZL 2005 2 0078943.2	2005 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 16 日止

2、发行人已提出下列专利注册申请：

序号	发明名称	专利类型	申请日	申请号	受理单位
1	长引线低弧度大面积薄型集成电路塑封生产方法	发明	2005 年 6 月 3 日	20051004268 8.0	国家知识产权局
2	长引线低弧度高密度金丝球焊生产方法	发明	2005 年 12 月 13 日	20051002272 7.0	国家知识产权局
3	光电一体化红外接收器与封装方法	发明	2005 年 6 月 21 日	20051004286 7.4	国家知识产权局
4	芯片封装件	实用新型	2006 年 6 月 13 日	20062007917 5.7	国家知识产权局
5	光聚式太阳能转电装置	实用新型	2006 年 6 月 13 日	20062007917 6.1	国家知识产权局
6	外接散热片型芯片封装件	实用新型	2006 年 6 月 13 日	20062007917 7.6	国家知识产权局
7	芯片倒装型封装件	实用新型	2006 年 6 月 13 日	20062007917 8.0	国家知识产权局

经核查，本所律师认为，上述专利权是由发行人提出专利申请，由国家知识产权局授予并颁发专利证书，不存在权属纠纷和限制专利权行使的情形，合法有效。上述专利注册申请已由国家知识产权局受理。

(三) 主要生产经营设备

根据《审计报告》，发行人截至 2006 年 12 月 31 日的主要生产经营设备如下：

单位：万元人民币

资产类别	原值	累计折旧	净值	减值准备	净额
通用设备	2,778.59	571.86	2,206.73	-	2,206.73
专用设备	36,318.32	9,008.71	27,309.61	-	27,309.61
运输设备	151.36	38.48	112.88	-	112.88
其他设备	232.66	55.28	177.38	-	177.38
合计	39,480.93	9,674.33	29,806.59	-	29,806.59

(四) 除土地使用权、专利权以外的无形资产

根据《审计报告》，截止 2006 年 12 月 31 日，发行人拥有的除土地使用权、专利权以外的其他主要无形资产如下：

单位：万元人民币

项 目	取得方式	初始金额	摊销年限	摊余价值	剩余摊销年限
ERP 系统	购入	70.86	10	61.20	8-9 年

经核查，本所律师认为，发行人上述主要生产经营设备和资产是在发行人设立时由华天微电子出资或在发行人设立后由发行人购买而取得的，上述资产为发行人所有，不存在权属争议或潜在纠纷。

(五) 房屋租赁

1、2006 年 6 月 1 日，发行人与华天微电子签订《房屋租赁协议》，向华天微电子租赁其位于天水市秦州区双桥路 14 号的华天公寓楼，建筑面积为 12192.557 平方米，租赁期限自 2006 年 6 月 1 日至 2009 年 5 月 31 日，租金总额为 3,618,903.96 元，每月 20 日前支付。

2、2007 年 1 月 20 日，发行人与七四九公司签订《房屋租赁合同》，向七四九公司租赁其位于天水市秦州区双桥路 14 号的 4,105.12 平方米厂房；租赁期限自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，租金为 492,614.40 元人民币，按月支付。

3、2007年1月24日，发行人与华天微电子签订《房屋租赁合同》，向华天微电子租赁其位于天水市秦州区双桥路14号、建筑面积为388.08平方米的房屋，租赁期限自2007年1月1日至2007年12月30日，租金总额为46,569.6元。

经核查，本所律师认为，发行人上述房屋租赁行为合法有效。

十一、发行人的重大债权、债务关系

(一) 发行人签订的正在履行和将要履行的重大合同

发行人除了上述正在履行的关联交易合同，还有下列正在履行和将要履行且可能对其生产、经营活动以及资产、负债和权益产生显著影响的重大合同：

1、借款合同

A、2006年4月17日，发行人与贷款人交通银行兰州分行签订编号为兰交银2006年第G630A01-10005号《借款合同》，借款金额为2,000万元，年利率6.633%，借款期限自2006年4月26日起至2009年4月26日。

B、2006年8月24日，发行人与贷款人中国农业银行天水市分行签订编号为62101200600007233《借款合同》，借款金额为2,000万元人民币，年利率6.732%，借款期限自2006年8月30日起至2007年8月30日。

C、2006年10月25日，发行人与贷款人中国农业银行天水市分行签订编号为62101200600008398《借款合同》，借款金额为1,000万元人民币，年利率6.732%，借款期限自2006年10月26日起至2007年10月26日。

D、2006年11月10日，发行人与贷款人中国农业银行天水市分行签订编号为62101200600008789《借款合同》，借款金额为1,000万元人民币，年利率6.732%，借款期限自2006年11月10日起至2007年11月9日。

E、2006年11月27日，发行人与贷款人天水市经济发展投融资有限公司签订编号为天经投（工）借贷字（2006）第001-1号的《借款转贷合同》，贷款金额为3,000万元人民币，年利率6.93%，贷款期限自2006年12月12日起至2009年12月12日。

F、2007年3月23日，发行人与贷款人中国农业银行天水市分行签订编号

为 NO.62101200700000568 号的《借款合同》，贷款金额为 3,000 万元人民币，年利率 7.425%，贷款期限自 2007 年 3 月 23 日起至 2011 年 3 月 22 日。

2、采购合同

A、2007 年 2 月 12 日，发行人与供货方贺利氏招远贵金属材料有限公司签订《金丝购销合同》约定，发行人向供货方采购金丝；具体产品编号、品名、数量由发行人于 2 周前向供货方确认的定单为准；金丝价格=金价*ADDER+加工费，黄金价格以供货方收到发行人的定单后第三个工作日上海黄金交易所上午开盘价为准；结算方式为每月结算；支付方式为电汇付款，特殊情况以承兑汇票结算；运输方式为 EMS 或空运，运费由供货方承担；合同期限为一年，自 2007 年 1 月 12 日至 2008 年 1 月 11 日。

B、2007 年 1 月 12 日，发行人与供货方宁波康强电子有限公司签订《长期供货协议》约定，发行人向供货方采购金丝、引线框架。具体产品编号、品名、数量以发行人向供货方确认的定单为准；具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定，若无国家物价管理部门规定的价格，则依据当地的市场价格双方议定，若没有当地的市场价格可依据，以来同类产品的市场价格双方议定；结算方式、支付方式、运输方式根据实际发生的具体采购事宜经双方议定；合同期限为一年，自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

C、2007 年 1 月 30 日，发行人与供货方汉高华威电子有限公司签订《长期供货协议》约定，发行人向供货方采购塑粉。具体产品编号、品名、数量以发行人向供货方确认的具体定单为准；具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定，若无国家物价管理部门规定的价格，则依据当地的市场价格双方议定，若没有当地的市场价格可依据，以来同类产品的市场价格双方议定；结算方式、支付方式、运输方式根据具体定单确定；合同期限为一年，自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

D、2007 年 2 月 7 日，发行人与供货方进峰贸易(深圳)有限公司签订《长期供货协议》约定，发行人向供货方采购引线框架。具体产品编号、品名、数量以发行人向供货方确认的具体定单为准；具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定，若无国家物价管理部门规定的价格，则依据当地的市场价格双方议定，若没有当地的市场价格可依据，以来同类产品的市场价格双方议定；结算方式、支付方式、运输方式根据具体定单确定；合同期限为一年，自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

E、2007年2月12日，发行人与广州丰江微电子有限公司签订《长期供货协议》约定，广州丰江微电子有限公司向发行人提供引线框架，发行人采购引线框架的具体型号、规格、数量质量标准以发行人的通知或按双方的约定标准，具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定，若无国家物价管理部门规定的价格，则依据当地的市场价格双方议定，若没有当地的市场价格可依据，以同类产品的市场价格双方议定；结算方式、支付方式、运输方式根据具体定单确定，合同期限自2007年1月1日至2007年12月31日。

F、2007年2月12日，发行人与上海长华新技电材有限公司签订《长期供货协议》约定，上海长华新技电材有限公司向发行人提供塑封料，发行人采购塑封料的具体型号、规格、数量质量标准以发行人的通知或按双方的约定标准，具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定，若无国家物价管理部门规定的价格，则依据当地的市场价格双方议定，若没有当地的市场价格可依据，以同类产品的市场价格双方议定；结算方式、支付方式、运输方式根据具体定单确定，合同期限自2007年1月1日至2007年12月31日。

G、2007年1月20日，发行人与日东电工(上海浦东新区)有限公司签订《长期供货协议》约定，该协议约定，日东电工(上海浦东新区)有限公司向发行人提供塑封料，发行人采购塑封料的具体型号、规格、数量质量标准以发行人的通知或按双方的约定标准，具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定，若无国家物价管理部门规定的价格，则依据当地的市场价格双方议定，若没有当地的市场价格可依据，以同类产品的市场价格双方议定；结算方式、支付方式、运输方式根据具体定单确定，合同期限自2007年1月1日至2007年12月31日。

H、2007年2月12日，发行人与西安安诺捷电子科技有限公司签订《长期供货协议》约定，西安安诺捷电子科技有限公司向发行人提供劈刀、料盘，发行人采购劈刀、料盘的具体型号、规格、数量质量标准以发行人的通知或按双方的约定标准，具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定，若无国家物价管理部门规定的价格，则依据当地的市场价格双方议定，若没有当地的市场价格可依据，以同类产品的市场价格双方议定；结算方式、支付方式、运输方式根据具体定单确定，合同期限自2007年1月1日至2007年12月31日。

I、2007年2月12日，发行人与铜陵丰山三佳微电子有限公司签订《长期供货协议》约定，铜陵丰山三佳微电子有限公司向发行人提供引线框架，发行人采购引线框架的具体型号、规格、数量质量标准以发行人的通知或按双方的约定标准，具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定，若无国家物价管理

部门规定的价格,则依据当地的市场价格双方议定,若没有当地的市场价格可依据,以同类产品的市场价格双方议定;结算方式、支付方式、运输方式根据具体定单确定,合同期限自2007年1月1日至2007年12月31日。

J、2007年2月12日,发行人与济南晶恒山田电子精密科技有限公司签订《长期供货协议》约定,济南晶恒山田电子精密科技有限公司向发行人提供引线框架,发行人采购引线框架的具体型号、规格、数量质量标准以发行人的通知或按双方的约定标准,具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定,若无国家物价管理部门规定的价格,则依据当地的市场价格双方议定,若没有当地的市场价格可依据,以同类产品的市场价格双方议定;结算方式、支付方式、运输方式根据具体定单确定,合同期限自2007年1月1日至2007年12月31日。

K、2007年2月12日,发行人与北京达博有色金属焊料有限责任公司签订《长期供货协议》约定,北京达博有色金属焊料有限责任公司向发行人提供金丝,发行人采购金丝的具体型号、规格、数量质量标准以发行人的通知或按双方的约定标准,具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定,若无国家物价管理部门规定的价格,则依据当地的市场价格双方议定,若没有当地的市场价格可依据,以同类产品的市场价格双方议定;结算方式、支付方式、运输方式根据具体定单确定,合同期限自2007年1月1日至2007年12月31日。

L、2007年2月12日,发行人与中山复盛机电有限公司签订《长期供货协议》约定,中山复盛机电有限公司向发行人提供引线框架,发行人采购引线框架的具体型号、规格、数量质量标准以发行人的通知或按双方的约定标准,具体产品价格按照国家物价管理部门规定的价格确定,若无国家物价管理部门规定的价格,则依据当地的市场价格双方议定,若没有当地的市场价格可依据,以同类产品的市场价格双方议定;结算方式、支付方式、运输方式根据具体定单确定,合同期限自2007年1月1日至2007年12月31日。

3、销售合同

A、2007年2月12日,发行人与委托加工人珠海炬力集成电路设计有限公司签订《委托加工合同》,发行人为委托加工人进行集成电路芯片的测试及加工装配。具体产品编号、品名、数量由委托加工人于每月28日前向发行人确认的定单为准;具体产品价格按照市场行情由双方商定,以每月25日作为结算日;支付方式为委托加工人收到发行人发票后的60日内付清;合同期限为一年,自2007年2月12日至2008年2月11日。

B、2007年2月12日，发行人与委托加工人上海贝岭签订《封装加工协议》，发行人为委托加工人进行DIP,SOP系列等IC芯片封装加工。具体产品编号、品名、数量由委托加工人于提前一个月向发行人确认的定单为准；具体产品价格按照市场行情由双方商定，每月结算一次；支付方式为委托加工人收到发行人发票后的60日内付清；合同期限为自合同生效之日起二年。

C、2007年1月8日，发行人与委托加工人无锡华润矽科微电子有限公司签订《IC封装加工承揽协议》及《IC封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人就委托加工人提供的集成电路芯片进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照《IC封装加工承揽协议附件》确定，以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次；支付方式为发行人开票日期后的60日内，委托加工人向发行人电汇或银行承兑汇票支付相应结算款项；运输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至2007年12月31日。

D、2006年12月15日，发行人与委托加工人绍兴芯谷科技有限公司签订《合同》，发行人为委托加工人进行IC芯片封装加工。具体产品编号、品名、数量等由委托加工人于每月20日前向发行人发出的订单为准；具体产品价格按照市场行情由双方商定，以每月的最后一天作为结算日，每月结算一次；支付方式为每次结算后的60日内，委托加工人向发行人支付相应结算款项；合同期限为签字之日起一年。

E、2007年1月24日，发行人与委托加工人无锡友达电子有限公司签订《IC封装加工承揽协议》及《IC封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人就委托加工人提供的集成电路芯片进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照《IC封装加工承揽协议附件》确定，以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次；支付方式为发行人开票日期后的60日内，委托加工人向发行人电汇支付相应结算款项；运输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至2007年12月31日。

F、2007年1月31日，发行人与委托加工人西安安诺捷电子科技有限公司签订《IC封装加工承揽协议》及《IC封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人提供的大园片（WAFER）进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照《IC封装加工承揽协议附件》确定，以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次；支付方式为发行人开票日期后的30日内，委托加工人向发行人电汇支付相应结算款项；运

输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至 2007 年 12 月 31 日。

G、2006 年 12 月 22 日，发行人与委托加工人深圳市中微半导体有限公司签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人就委托加工人提供的集成电路芯片进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照报价单确定，以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次；支付方式为发行人开票日期后的 60 日内，委托加工人向发行人电汇支付相应结算款项；运输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至 2007 年 12 月 31 日。

H、2007 年 2 月 2 日，发行人与委托加工人无锡汇宇电子有限公司签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人就委托加工人提供的大园片（WAFER）进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照《IC 封装加工承揽协议附件》确定，以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次；支付方式为发行人开票日期后的 60 日内，委托加工人向发行人电汇支付相应结算款项；运输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至 2007 年 12 月 31 日。

I、2006 年 12 月 20 日，发行人与委托加工人深圳市天光集成电路有限公司签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人就委托加工人提供的集成电路芯片进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照报价单确定，以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次；支付方式为发行人开票日期后的 60 日内，委托加工人向发行人电汇支付相应结算款项；运输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至 2007 年 12 月 31 日。

J、2007 年 1 月 24 日，发行人与委托加工人无锡硅动力微电子有限公司签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人就委托加工人提供的集成电路芯片进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照《IC 封装加工承揽协议附件》确定，以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次；支付方式为发行人开票日期后的 60 日内，委托加工人向发行人电汇支付相应结算款项；运输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至 2007 年 12 月 31 日。

K、2007 年 1 月 25 日，发行人与委托加工人无锡创芯微电子有限公司签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人

就委托加工人提供的集成电路芯片进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照《IC 封装加工承揽协议附件》确定，以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次；支付方式为发行人开票日期后的 60 日内，委托加工人向发行人电汇支付相应结算款项；运输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至 2007 年 12 月 31 日。

L、2006 年 12 月 8 日，发行人与委托加工人深圳市富满电子有限公司签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人就委托加工人提供的集成电路芯片进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照报价单确定，以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次；支付方式为发行人开票后，委托加工人向发行人电汇支付相应结算款项；运输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至 2007 年 12 月 31 日。

M、2007 年 1 月 29 日，发行人与委托加工人上海昕电子有限公司签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人就委托加工人提供的集成电路芯片进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照报价单确定，以每月的最后一天作为结算终止期，月结 60 日；支付方式为委托加工人向发行人电汇支付相应结算款项；运输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至 2007 年 12 月 31 日。

N、2007 年 1 月 31 日，发行人与委托加工人安徽华宇电子科技有限公司签订《IC 封装加工承揽协议》及《IC 封装加工承揽协议附件》，发行人为委托加工人就委托加工人提供的大园片（WAFER）进行塑封加工服务。委托加工人提前一个月书面通知发行人下月的封装数量；具体加工品种及价格按照《IC 封装加工承揽协议附件》确定，以每月的最后一天作为结算终止期，每月结算一次；支付方式为发行人开票日期后的 30 日内，委托加工人向发行人电汇支付相应结算款项；运输方式为由发行人送货；协议期限自签字之日起至 2007 年 12 月 31 日。

4、担保合同

A、2006 年 8 月 24 日，发行人与抵押权人中国农业银行天水市分行签订编号为 62906200600000520《最高额抵押合同》，发行人以房地产和机器设备作价 7,583 万元人民币，为其在 2006 年 8 月 30 日起至 2008 年 8 月 30 日期间在抵押权人处所实际形成债务的最高余额折合人民币 4,000 万元及利息提供担保。

B、2006年11月27日,发行人与抵押权人天水市投资担保有限公司签订《机器设备抵押合同》,为其与抵押权人签订的《担保协议书》提供反担保,担保金额为人民币3,000万元,抵押物为发行人所有的价值6,032万元人民币的机器设备,抵押期限自2006年11月27日至2009年11月27日。

C、2007年3月23日,发行人与抵押权人中国农业银行天水市分行签订编号为62906200700000057《最高额抵押合同》,发行人以机器设备作价10,836万元做抵押,为其在2007年3月23日起至2011年3月23日期间在抵押权人处所实际形成的债务的最高余额折合人民币3,000万元及利息提供担保。

5、承销协议和保荐协议

A、2007年3月,发行人就本次发行及上市与主承销商国信证券有限责任公司签署了《天水华天科技股份有限公司与国信证券有限责任公司签订的天水华天科技股份有限公司首次公开发行股票之主承销协议》,该协议就国信证券有限责任公司作为主承销商承担发行人本次发行及上市事宜作了规定,内容包括:承销安排、承销费用、各方权利义务等。

B、2007年3月,发行人就本次发行及上市与保荐人国信证券有限责任公司签署了《天水华天科技股份有限公司与国信证券有限责任公司签订的天水华天科技股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议》,该协议就国信证券有限责任公司作为保荐人承担发行人本次发行股票及上市的保荐事宜作了规定,内容包括:保荐工作范围、保荐费用、各方权利义务等。

6、其他合同

A、2007年3月16日,发行人与承运方中铁快运股份有限公司兰州分公司签订《委托运输协议》,发行人委托承运方负责路线货物的发运工作,承运方根据发行人提供的托运单进行货物发运和投送,运费采取周结或月结的方式,运价和期限按双方确认的(附件)执行;合同期限自2007年3月17日至2007年12月31日。

B、2007年3月12日,发行人与承运方兰州金凤凰航空货运服务有限公司签订《委托运输协议》,发行人委托承运方负责商定路线货物的发运工作,承运方根据发行人提供的托运单进行货物发运和投送,运费采取周结或月结的方式,运价和期限按双方确认的(附件)执行;合同期限自2007年3月13日至2007年

12月31日。

C、2006年12月30日，发行人与供电方甘肃省电力公司天水供电公司签订《高压供用电合同》，供电方向发行人提供三相交流50HZ电源，采用由多电源提供的多回路向发行人供电。电价按照有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录，定期向发行人结算电费及随电量征收的有关费用；合同期限自2006年10月30日起至2007年10月29日。

经核查，本所律师认为，发行人上述合同不存在主体变更的情形，上述合同的内容和形式合法有效，上述合同的履行不存在法律障碍。

(二) 发行人发生的侵权之债

经核查，本所律师认为，发行人没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而发生的侵权之债。

(三) 发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保情况

1、2006年4月17日，华天微电子与抵押权人交通银行兰州分行签订编号为兰交银2006年第G630A01-10005号《抵押合同》，华天微电子以“华天公寓楼”在建工程抵押，为发行人贷款2000万元人民币提供担保。发行人借款期限为2006年4月26日至2009年4月26日，华天微电子的抵押保证期间为借款期限届满后两年。

2、2006年6月26日，华天微电子与抵押权人天水农行签订编号为62901200600030437《保证合同》，华天微电子为发行人贷款700万元人民币提供连带责任保证担保。发行人借款期限为2006年6月27日至2007年7月26日，华天微电子的保证期间为借款期限届满后两年。

经核查，本所律师认为，除本工作报告出具之日已披露的以外，发行人与股东之间不存在其他重大债权债务关系，也不存在发行人为股东提供担保的情形。

(四) 发行人金额较大的其他应收应付款

经核查，本所律师认为，发行人金额较大的其他应收、应付款是因正常的生产经营活动发生，合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

(一) 发行人的增资扩股

发行人2004年增资扩股和2006年增资扩股的情况和核查意见如本工作报告第七部分“发行人的股本及其演变”所述。

(二) 发行人的资产收购

发行人收购华天微电子持有华天包装100%的股权、持有华天机械60%的股权以及2,408平方米土地使用权的情况和核查意见如本工作报告第九部分“发行人的关联交易及同业竞争”所述。

(三) 发起人其他重大资产变化和收购兼并

经核查，本所律师认为，发行人自设立至今不存在合并、分立、减少注册资本、出售资产等行为，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售等行为。

十三、发行人章程的制定与修改

(一) 2003年制定章程

2003年12月21日，发行人召开了创立大会，依法通过了发行人章程。

(二) 2004年修改章程

2004年3月28日，发行人因增加增资扩股事宜，召开2004年第二次临时股东大会，依法通过了公司章程修正案，对章程进行了相应修改。

(三) 2006年修改章程

1、2006年6月26日，发行人召开了2006年第一次临时股东大会，因增资扩股事宜，并根据《中华人民共和国公司法（2005年修订）》的有关规定对章程进行了修改。

2、2006年7月18日，发行人因股权转让事宜，并根据《中华人民共和国

公司法（2005年修订）》的要求，召开2006年第二次临时股东大会，对章程进行了修改。

3、2006年11月29日，发行人因股权转让事宜，召开2006年第三次临时股东大会，依法通过了公司章程修正案，对章程进行了相应修改。

（四）2007年修改章程

1、2007年2月16日，发行人因股东名称变化及董事会、监事会人数变化，召开2007年第一次临时股东大会，依法通过了公司章程修正案，对章程进行了相应修改。

2、2007年3月10日，发行人召开2006年度股东大会，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）成功后适用的〈章程（草案）〉的议案》，按照《公司法》和《上市公司章程指引（2006年修订）》修改了发行人首次公开发行人民币普通股（A股）成功后适用的《章程（草案）》。该《章程（草案）》待中国证监会核准本次发行并于交易所挂牌后生效。

经核查，本所律师认为：

（1）发行人章程的制定及修改已履行法定程序。

（2）发行人章程的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（3）发行人章程已经按有关上市公司章程的规定修订，发行人章程与《上市公司章程指引（2006年修订）》不存在不一致的条款。

（4）上述《章程（草案）》的内容合法，待中国证监会核准本次发行并于交易所挂牌后生效。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

发行人的组织机构图详见本律师工作报告第五部分“发行人的独立性”。

经核查，本所律师认为，发行人具有健全的组织机构。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

经核查，本所律师认为，发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事

规则，该议事规则符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

(三)发行人的股东大会、董事会、监事会运作

经核查，本所律师认为：

(1) 发行人历次股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效；股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

(2) 发行人在三会运作中存在以下不规范之处：a) 在审议 2004 年增资扩股事项的 2004 年第二次股东大会中，作为拟增资方的盈富泰克，在尚不具备股东资格时即出席股东大会并参与表决；b) 召开 2006 年第二次临时股东大会的通知时间不足《公司法》、发行人章程规定的期限。经核查，对于上述事项，未有发行人股东提出任何异议，且发行人已在本次发行及上市的辅导过程中规范了三会运作。因此，发行人三会运作中的上述不规范之处不影响相关决议的合法性，发行人历次股东大会、董事会、监事会的召开合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经核查，本所律师认为：

(1) 截止本工作报告出具之日，发行人董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及发行人章程的规定。

(2) 发行人董事、监事和高级管理人员的构成没有出现对发行人的经营管理有重大影响的人员变化，而前述变化履行了必要的法律程序。

(3) 发行人已设立独立董事，独立董事任职资格符合有关规定，其职权范围不违反有关法律、法规和规范性文件的规定。

十六、发行人的税务

(一) 发行人执行的税种、税率

根据《审计报告》，发行人执行的税种、税率如下：

1、增值税

1) 发行人为增值税一般纳税人。按产品销售收入17%的税率计算销项税额；供电服务按劳务收入的17%、水暖服务按劳务收入的13%的税率计算销项税额。

2) 发行人为集成电路生产企业，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》(财税[2002]70号)的规定以及甘肃省电子信息工业办公室、甘肃省国家税务局《关于认定天水华天科技股份有限公司为集成电路生产制造企业的批复》(甘电行规[2004]2号)，并经天水市秦城区国家税务局秦国税免字[2004]第3号《减、免税批准通知单》核定，发行人销售自产的集成电路产品增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。该优惠政策自2005年4月1日起停止执行。

2、企业所得税

1) 按应纳税所得额的33%计算缴纳所得税。

2) 根据发行人于2004年5月11日填制的《企业享受西部大开发税收优惠政策申请审批表》和《纳税人减免税审批表》，经甘肃省国家税务局审核同意，发行人根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》(财税〔2002〕70号)以及国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]147号)规定，在2004年1月至2005年12月期间免征企业所得税，2006年1月至2010年12月期间按15%的税率征收企业所得税。

3、城市维护建设税：按应交增值税、营业税税额的7%计提。

4、教育费附加：按应交增值税、营业税税额的3%计提。

5、营业税：按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳。

(二) 发行人享受的其他税收优惠政策

依照财政部、国家税务总局发布的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》(财税字[1999]290号)和国家税务总局发布的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》(国税发[2000]13号)的规定，经甘肃省国家税务局审核并以甘国税批字[2006]60号和甘国税批字[2006]82号《甘肃省国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书》批准，发行人享有技术改造国产设备投资抵免企业所得税资格。

(三) 发行人的纳税

根据天水市秦州区国家税务局和天水市秦州区地方税务局2007年3月分别就发行人的纳税情况出具的《证明》，发行人自成立以来一直依法纳税，没有违反税法的行为，未受过税务行政处罚。

经核查，本所律师认为：

(1)发行人执行的增值税、城市维护建设税、教育费附加、所得税和其他税种的适用税率符合国家法律、法规和地方法规的要求。

(2)发行人享受上述税收优惠政策是合法、合规、真实、有效的。

(3)发行人近三年来依法纳税，没有被税务部门处罚的情况。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

(一) 发行人的环境保护

经核查，本所律师认为：

(1)发行人近三年来生产经营活动和拟投资项目符合有关环境保护的要求，环保部门已出具同意项目建设的审批意见。

(2)发行人近三年不存在因违反环境保护方面的法律、法规而被处罚的情形。

(二) 发行人的产品质量、技术等标准

经核查，本所律师认为，发行人近三年来生产的产品符合有关质量和技术监督标准，没有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情况。

十八、发行人募集资金的运用

根据发行人于2007年3月10日召开的2006年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》，本次发行及上市的募集资金用于发行人集成电路高端封装产业化项目，主要生产LQFP、TSSOP、QFN、BGA、MCM等高端封装产品(以下简称“本次募集资金项目”)。

经核查，本所律师认为：

(1)本次募集资金项目已经甘肃省发展与改革委员会登记备案，并取得环保部门同意项目建设的审批意见。

(2)本次募集资金项目不涉及与他人合作，项目完成后不存在同业竞争。

十九、发行人业务发展目标

经核查，本所律师认为：

- (1) 发行人业务发展目标与主营业务一致。
- (2) 发行人业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚

经核查，本所律师认为，发行人目前没有尚未了结的、可以合理预见的、对发行人资产持有和业务经营有重大不利影响的诉讼、仲裁案件或行政处罚案件。

(二) 持有发行人 5% 以上（含 5%）的主要股东、发行人控股子公司的诉讼、仲裁或行政处罚

经核查，本所律师认为，持有发行人 5% 以上（含 5%）的主要股东华天微电子、盛宇投资、盈富泰克、士兰微电子、友旺电子、遐略投资，发行人的控股子公司华天包装、华天机械目前没有尚未了结的、可以合理预见的、对发行人资产持有和业务经营有重大不利影响的诉讼、仲裁案件或行政处罚案件。

(三) 发行人实际控制人的诉讼、仲裁或行政处罚

经核查，本所律师认为，作为发行人实际控制人的 16 名自然人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

(四) 发行人董事长、总经理的诉讼、仲裁或行政处罚

经核查，本所律师认为，发行人董事长肖胜利先生和总经理刘建军先生不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价

发行人《招股说明书》由发行人和保荐人（主承销商）编制，本所律师参与讨论并审阅了《招股说明书》，特别对发行人引用法律意见书和本律师工作报告相关内容进行了审阅，发行人《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十二、结论意见

本所认为，发行人符合股票发行上市条件，发行人行为不违法违规，招股说明书及其摘要引用的本法律意见书和律师工作报告的内容适当。

[此页无正文，为江苏法德永衡律师事务所关于天水华天科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市出具的法律意见书之签章页]

本法律意见书正本八份，无副本。



负责人:


谈 臻

经办律师:



景 忠



梁 峰

二〇〇七年三月二十八日